

# 合肥晶合集成电路股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行回报社会的责任感，合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营管理水平，完善公司治理，强化市场竞争力，积极回报投资者，保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，树立良好的资本市场形象。相关方案如下：

### 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力

2024 年，公司将继续积极聚焦主营业务，提升科技创新能力，持续加大研发投入力度，全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及行业内口碑，实现高质量发展，以优异的业绩回报投资者。具体包括以下几个方面：

#### 1、重视质量管理，强化产品质量

公司始终重视质量管理体系建设，截至目前，公司已取得质量管理体系认证 ISO9001，环境管理体系认证 ISO14001，职业健康安全管理体系认证 ISO45001，有害物质过程管理体系 QC080000，温室气体排放盘查认证 ISO14064 等诸多认证。此外，在车用芯片领域，公司已取得国际汽车行业质量管理体系认证，并通过多个工艺平台的车规验证。2024 年度，公司将继续以技术创新为核心动力，大力研发具有自主知识产权的核心技术，不断提升产品质量，丰富技术储备，并引入先进的生产设备和技术，加强质量管理，提升产品的稳定性和可靠性。

#### 2、优化产品结构，丰富产品线

2023 年度，公司主要产品 DDIC、CIS、PMIC、MCU 占主营业务收入的比例分别为 84.79%、6.03%、6.04%、1.71%，主轴产品 DDIC 继续巩固优势，其他产品竞争力持续稳步提升；同时，2023 年公司高阶 55nm 产品实现大规模量产且市场需求较高，公司 55nm 产能利用率持续维持高位水平，占主营业务收入的比例较 2022 年增加 7.46 个百分点。

2024 年度，公司将致力于丰富自身产品结构及强化自身技术能力，在巩固现有 DDIC、CIS、PMIC、MCU 等产品的情况下，持续扩大应用领域及开发高阶产品，提升产品竞争优势及多元化程度。其中，在 CIS 产品领域，公司 55nm 单芯片、高像素背照式图像传感器（BSI）于近期迎来批量量产，极大赋能智能手机的不同应用场景,实现由中低端向中高端应用跨越式迈进，并成为显示驱动芯片之外的第二大产品主轴；在 OLED 驱动芯片代工领域，公司 40nm 的 OLED 驱动芯片目前已经开发成功并正式流片，28nm 产品开发正在稳步推进中，未来将具备完整的 OLED 驱动芯片工艺平台；针对 AR/VR 微型显示技术，公司正在进行硅基 OLED 相关技术的开发，目前已与国内面板领先企业展开深度合作，加速应用落地；此外，公司积极配合汽车产业链的需求，布局车用芯片市场，目前已初步形成产业生态体系。在汽车芯片制造能力建设上，公司已取得国际汽车行业质量管理体系认证，并通过多个工艺平台的车规验证，公司将持续推进车规级产品认证，全面进入汽车电子芯片市场。未来，公司平台及产品结构将日益丰富，产品应用涵盖消费电子、智能手机、智能家电、安防、工控、车用电子等诸多领域，为客户提供更加丰富的产品解决方案。

### **3、加大研发投入，提升核心竞争力**

公司高度重视研发体系建设，持续增加研发投入，以保证技术和产品持续创新，提高产品市场竞争优势。2023 年，公司研发投入为 105,751.18 万元，占营业收入的比例为 14.60%，较 2022 年增加 6.07 个百分点；截至 2023 年底，公司拥有研发技术人员 1,660 名，占员工总人数比例为 36.13%。研发人员中硕士及以上学历占比为 61.75%；公司新增专利 275 个，其中发明专利 231 个，截至 2023 年末公司累计获得专利 694 个。2023 年，公司 55nm TDDI 实现大规模量产、40nm 高压 OLED 平台正式流片。

公司坚持不断开发新产品和新工艺，横向延伸拓宽产品种类，满足客户和市场对产品多样化的需求；纵向通过技术研发创新，开发新产品、向更先进制程节点发展，加快 40nm、28nm 等制程和车规级芯片的研发。公司在研发方面会持续投入资源，以加强公司核心技术的能力，全面提升产品组合的技术竞争力。未来几年，公司重点投入的研发项目进展与达成目标如下：

序号	项目名称	研发进展	拟达到目标	具体应用前景
1	28nm 逻辑及 OLED 芯片工艺平台	工艺制程验证阶段	完成平台开发, 包括全套低、中、高压器件, 提供大容量 SRAM, 降低功耗, 适应各种高端显示技术需求。	视频 SoC、图像处理 (ISP)、信号传输及视频桥接芯片、时序控制芯片、内存控制器、FPGA、CPU、高阶智能手机 OLED 屏
2	40nm OLED 芯片工艺平台	工艺制程验证阶段	完成平台开发, 为客户提供多尺寸存储单元, 并实现批量生产	智能手机 OLED 屏、笔记本电脑 OLED 屏
3	55nm OLED 显示驱动芯片技术平台	工艺制程验证阶段	完成平台开发及车规验证, 并实现批量生产	智能手机 OLED 屏、笔记本电脑 OLED 屏
4	90nm 高阶显示驱动芯片工艺平台	工艺制程验证阶段	开发高压组件, 提高驱动能力, 导入客户并实现批量生产	电子标签、电子纸等电子产品
5	110nm 高阶显示驱动芯片工艺平台	工艺制程验证阶段	完成平台开发, 满足车规、超低漏电等多种工艺需求, 实现产品批量生产	VR 眼镜/AR 眼镜/抬头显示/辅助显示/车用 LCD 面板/仪表盘/笔记本电脑
6	150nm 大尺寸面板显示驱动芯片技术平台	工艺制程验证阶段	完成平台开发, 形成高速低压与高压器件, 协助客户开发更高质量, 更具竞争力产品	大尺寸影音面板
7	55nm CMOS 后照度图像传感器平台	工艺制程验证阶段	完成 55 纳米前照度和后照度工艺制程验证, 导入客户, 实现批量生产	智能手机、安防、无人机、游戏娱乐、工业自动化等
8	90nm 高阶 CMOS 图像传感器技术平台	工艺制程验证阶段	完成 90 纳米图像传感器工艺制程验证, 进行车规级可靠性验证, 导入客户, 并实现批量生产	智能手机、安防、无人机、游戏娱乐、工业自动化等
9	110nm 高阶微控制器平台	风险量产阶段	完成平台开发, 通过车规级可靠性验证, 导入客户, 实现批量生产。	智能家电、办公设备及通用型车用控制器、PC/笔记本电源等
10	90nm BCD 电源管理芯片技术平台	工艺制程验证阶段	完成平台开发及 AEC-Q100 车规可靠性测试, 导入客户实现批量生产	接口芯片、快充协议芯片、手机电源管理芯片等
11	110nm 高压电源管理芯片技术平台	工艺制程验证阶段	完成平台开发, 降低器件导通电阻, 提高器件耐压, 导入客户并实现批量生产	快充协议芯片、音频功放、消费电子电源管理芯片等

12	150nm 电源管理芯片技术平台	工艺制程验证阶段	完成平台开发, 提高器件耐压, 达到客户器件规格需求, 提升产品良率, 实现产品批量生产	负载开关、DC-DC、AC-DC 转换、LED 照明、电机驱动、LDO 各式电源驱动、快充协议芯片等
13	功率半导体技术平台	工艺制程验证阶段	完成功率半导体工艺平台开发, 降低器件导通电阻并提高器件耐压, 导入客户并实现批量生产	工业电机控制、车用电机等
14	光罩研发项目	技术开发阶段	导入客户实现批量生产	芯片掩模版

#### 4、加强募投管理，推进募投项目建设

2023 年 5 月, 公司在上海证券交易所科创板挂牌上市, 募集资金净额为 97.24 亿元。截至 2023 年末, 募集资金累计投入 58.70 亿元, 累计投入进度 60.37%。其中, 公司募投项目“收购制造基地厂房及厂务设施”已于 2023 年 9 月收购完成并取得相关产权证书, 并于 2023 年 12 月召开董事会予以结项; 募投项目“后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目(包含 90 纳米及 55 纳米)”及“40 纳米逻辑芯片工艺平台研发项目”受市场需求变动的影 响, 公司根据行业技术的最新发展情况进行了工艺优化、技术调整, 使得部分募投项目的实际投资进度与原预期计划存在差异, 公司审慎研究决定对上述项目达到预定可使用状态的日期分别调整至 2024 年底、2025 年中。2024 年, 公司将会持续加强募投项目管理, 在募投项目的实施过程中, 严格遵守募集资金管理规定, 审慎使用募集资金, 切实保证募投项目按规划顺利推进, 以募投项目的落地促进公司主营业务发展, 实现募投项目预期收益, 增强公司整体盈利能力。

## 二、优化运营管理，实现降本增效

### 1、加强生产管理，强化资源整合

公司不断提升精细化管理水平, 加强内部生产管理与资源整合, 持续优化和提升生产运营效率。公司持续通过工艺优化等手段提升生产效率, 降低生产成本, 实现降本增效, 提升公司核心竞争力。2020 年公司智能生产线获得安徽省智能工厂认证, 其高端智能制造营运管理制度及系统, 涵盖数字化生产系统、自动化无人搬运系统、车间自动化控制系统、智能品质与设备监控系统、智能生产派工

系统等，可为客户提供更优质代工服务及更稳定的品质。此外，公司持续深耕本地产业链配套，从原材料到整机产业链，可实现就近供应，使自身产品成本更具竞争力。

## **2、提高资金效率，重视应收账款管理**

由于公司所处半导体设备行业具有资金密集性的特征，产品技术升级快，研发投入大，并且研发投入早于应用层面，因此公司需要将有限的资金合理利用，使得研发成果与产品布局早于客户需求。公司将通过优化库存、加快新产品在客户端的验收、加快回款等举措，提高资金使用效率。

公司积极展开应收账款管理工作，建立了与业务的监管合作机制，加强内部培训和宣传，做好事前事中事后管控。公司对主要客户的信用政策评定综合考虑业务部门评估及财务部门评估两方面，业务部门根据客户的市场占有率、产品市场竞争力、对公司产能贡献率综合评判提出授信额度，财务部门根据客户提供的经审计财务报表/盖章财务报表，计算客户短期偿债能力、盈利能力等关键指标，并根据计算指标进行评分，经综合评估后确定客户信用政策。后期为加强日常监管，公司设定专人专岗定期监测应收账款回收情况，保障应收账款的有效管理与回收。过去几年，应收账款周转天数一直控制在合理范围，效果明显。2024 年公司将持续优化应收账款管控措施，进一步增加经营活动现金流入。

## **3、重视人才队伍建设，构建义利共生的人才战略**

2024 年度，公司将继续引进和培养各方面的人才，同时吸纳全球高端人才，优化人才结构；公司将加强员工培训，继续完善员工培训计划，形成有效的人才培养和成长机制，通过内外部培训、课题研究等方式，提升员工业务能力与整体素质，在鼓励员工个性化、差异化发展的同时，培养团队意识，增强合作精神，打造世界级的一流人才团队，实现公司可持续发展。

同时，公司制定了与公司经营业绩与研发进展紧密相关的激励计划，有助于激励管理层及核心员工积极关注股东利益并努力提升公司绩效。公司对激励计划设定了  $\Delta$ EVA、净利润增长率及新工艺销售收入占主营业务收入占比三项公司层面业绩考核要求，和严密的绩效考核体系作为个人层面的业绩考核要求。上述考核要求锚定公司经营状况、成长性、盈利能力等与投资者利益紧密相关的指标，并设定了具有一定挑战性的考核目标，有助于提升公司整体发展质量，增强投资

者回报。2024 年，公司将继续积极实施股票激励计划，制定更为精准的业绩考核指标，实施考核管理办法进行严格考核，确保被激励对象与公司、股东方利益保持一致，形成良好的共担共享约束机制。

### **三、完善公司治理，推动公司高质量发展**

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。具体工作如下：

#### **1、持续完善内控体系建设**

2023 年，公司根据中国证监会、上海证券交易所最新发布的相关规则，结合公司实际情况，完成 24 项治理制度的修订工作。2024 年，公司持续优化现有内控制度，目前已完成 12 项治理制度的制定、修订工作。公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，建立健全的法人治理结构和完善的内部控制体系，为企业经营管理的合规有效提供了保障，为公司高质量发展保驾护航。

#### **2、强化“关键少数”责任，实现利益共担共享约束**

长期以来，公司与控股股东以及公司董监高等“关键少数”人员保持紧密沟通，按照有关要求积极组织相关人员参加有关专项培训，定期普及最新法律法规和监管学习案例，促进“关键少数”人员持续提升合规意识，维护全体股东利益。2024 年度，公司将持续加强与“关键少数”人员的日常沟通，并将充分借助培训平台资源，组织“关键少数”及公司经营管理层进行线上、线下的培训不少于四次。同时，向公司经营管理团队普及监管政策的变化及其对公司业务的影响，了解信息披露、重大事项报告、内幕信息管理中的职责，引导全员树立合规意识，引领公司在合规的基础上实现稳健发展。

为调动公司管理团队的积极性、主动性和创造性，推动公司实现高质量发展，公司结合年度财务状况、经营业绩等目标的综合完成情况对公司高级管理人员进行绩效考评，将高级管理人员薪酬调整、支付、分配与公司业绩经营相挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的激励、考核和方案实施。将公司高级管理人员业绩考核及薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，

有利于保障公司的长期稳定发展，增强投资者信心。

### **3、加快落实独董制度改革，发挥独董监督作用**

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，公司于 2024 年 3 月召开股东大会，进一步优化修订了《独立董事工作制度》《公司独立董事年报工作制度》等内控制度。公司将于 2024 年持续贯彻中国证监会独立董事制度改革的精神，通过现场会议、各分支机构考察、重点事项汇报等方式，为独立董事履职提供便利条件，保障独立董事在每年不少于 15 天的工作日能高效的开展工作；定期评估独立董事的独立性。贯彻财政部、国资委与证监会就会计师聘任的有关规定，落实审计机构选聘细则，将外部审计机构对企业的监督内化为企业合规管理的推动力。

## **四、贯彻可持续发展的经营理念，积极践行社会责任**

公司高度重视环境、社会及管治（ESG）工作对企业的重要作用，按照可持续发展的经营理念，将环境保护、社会责任与企业经营有机结合，开展与利益相关方广泛的沟通与合作，不断提升公司经营管理水平。

公司于 2023 年首次发布的《2022 年年度社会责任报告》向社会及利益相关者全面展现了公司在环境、社会责任以及公司治理等方面的 ESG 实践成果。公司致力于推进 ESG 管理的创新实践，立志成为业内引领双碳目标的先锋。2024 年，公司将持续高质量发布 ESG 报告，并持续推动 ESG 体系融入企业经营管理各环节，完善工作机制，提升 ESG 实践的专业性、系统性，更好地满足国内、国际投资者对公司 ESG 管理与实践信息的关注和需求，增强其对公司发展的信心。

## **五、提高信息披露水平，加强投资者沟通**

公司高度重视信息披露工作，严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求开展信息披露工作，致力于保障所有股东享有平等的知情权，并通过文字、图表、图片等多种形式相结合让全体投资者能够及时了解公司的经营情况和投资价值。公司设立了投资者关系专用邮箱与投资者沟通热线，并于公司官网（[www.nexchip.com.cn](http://www.nexchip.com.cn)）设置“投资者关系”频道，其中下设了“公司治理”、“股票信息”、“财务报告”、“公司公告”、“投资者服务”多个分栏。

公司致力于保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。2024 年度，公司将召开不少于三次业绩说明会，通过视频或文字直播、定期报告、企业社会责任报告等形式，全方位向投资者展示业绩和社会责任履行情况；公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，倾听投资者声音，并在合法合规的范围内做出针对性回应。

## **六、积极实施股份回购，重视投资者回报**

### **1、实施股份回购**

基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为完善公司长效激励机制，同时为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期健康发展，进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制，使各方更紧密地合力推进公司长远、稳定、持续发展，公司将使用不低于人民币 50,000 万元（含），不高于人民币 100,000 万元（含）的超募资金、自有及自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。2024 年 3 月，公司股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，回购价格为不超过人民币 25.26 元/股（含）。公司已于 2024 年 4 月 8 日通过集中竞价交易方式首次回购股份 851,136 股，占公司总股本 2,006,135,157 股的比例为 0.04%，支付的资金总额为人民币 11,439,167.19 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），公司将按计划持续实施股份回购并及时履行信息披露义务。

### **2、股东分红回报规划**

为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，公司制定了《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后股东分红回报三年规划》，并在《公司章程》中对利润分配做了相应的规定，明确了公司利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则。未来，公司将积极响应中国证监会、上海证券交易所倡导的现金分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科



学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。

### 3、稳定股价预案

为保持公司上市后股价稳定，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，公司、实际控制人、公司控股股东及其一致行动人、公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员承诺自公司首次公开发行上市之日起三年（36个月）内，如非因不可抗力因素所致，在公司A股股票收盘价格出现连续20个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产值（第20个交易日构成“触发日”，每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷期末公司股份总数；最近一期审计基准日后，公司如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产需相应进行调整）的条件满足时，将依据法律法规及公司章程的规定并取得相关主管部门批准或认可的情形下，且在不影响公司上市条件的前提下实施稳定股价的措施。

## 七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2024年4月12日